

CC800[®] HiPIMS

HiPIMS HIGH POWER IMPULSE MAGNETRON SPUTTERING



Beschichtungsraum, Ø x h	[mm]	Ø400 x 400
Substrattisch, Ø x Ø Satelliten x Anzahl Satelliten	[mm], Stück	Ø400 x Ø130 x 6
Kathoden	Stück, [mm]	6 x 500 (davon 4 wahlweise HiPIMS/DC sowie 2 weitere DC; alle Kathoden sind mit Shuttern ausgerüstet)
Maximale Substratabmessungen, Ø x h	[mm]	Ø400 x 800
Kapazität Bohrer, Ø6 mm x 60 mm	Stück	1.800
Kapazität WSP, 12,7 mm x 3,5 mm	Stück	4.920
Beladung	[kg]	250
Schichtrate	µm/h	2 µm/h HiPIMS
Zykluszeit für 3 µm FerroCon ^{®*}	[h]	4,5
Prozessverfahren	HiPIMS und Sputtern mit Booster-Technologie. Alle etablierten CemeCon Schichten sind möglich.	
Substratvorbehandlung (Plasmaätzen)	Booster-, MF- und HiPIMS-Ätzen	
elektrisch leitende Schichten	ja	
elektrisch nicht leitende Schichten	ja	
elektrisch nicht leitende Substrate	ja	
Anschlussleistung	[kW]	80
Stromverbrauch pro Charge für 3 µm FerroCon ^{®*}	[kWh]	120
Aussenabmessungen (b x l x h)	[mm ³]	1.450 x 3.350 x 2.200

* pure HiPIMS Schicht auf 10 mm Fräser, volle Beladung, 3-fach-Rotation